2025年半导体材料标准工作会议预安排（按项目顺序排列）

| 序号 | 标准名称 | 计划号 | 讨论（任务落实）月份 | 预审月份 | 审定月份 | 应报批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 半导体单晶材料透过率测试方法 | 国标委发[2023]58号20231111-T-469 | - | - | 3 | 2025.6.1 |
|  | 金刚石单晶抛光片位错密度的测试方法 | 国标委发〔2024〕16号20240136-T-469 | - | 3 | 8 | 2025.9.25 |
|  | 蓝宝石图形化衬底表面图形几何参数的测定方法 | 国标委发〔2024〕16号20240137-T-469 | - | 5 | 8 | 2025.9.25 |
|  | 氮化铝单晶抛光片 | 国标委发〔2024〕16号20240138-T-469 | - | 3 | 8 | 2025.9.25 |
|  | 硅外延用三氯氢硅中杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 国标委发〔2024〕16号20240139-T-469 | - | - | 5 | 2025.7.25 |
|  | 蓝宝石单晶衬底抛光片 | 国标委发〔2024〕16号20240142-T-469 | - | - | 5 | 2025.7.25 |
|  | 重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的测试 红外反射法 | 国标委发〔2024〕16号20240143-T-469 | - | - | 5 | 2025.7.25 |
|  | 氮化硅粉体中铁、铝、钙含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 国标委发〔2024〕16号20240149-T-469 | - | - | 3 | 2025.9.25 |
|  | 碳化硅单晶抛光片堆垛层错测试方法 | 国标委发〔2024〕16号20240494-T-469 | - | 3 | 8 | 2025.9.25 |
|  | 半导体晶片近边缘几何形态评价 第2部分：边缘卷曲法（ROA） | 国标委发〔2024〕16号20240496-T-469 | - | - | 7 | 2025.9.25 |
|  | 太阳能电池用硅单晶及硅单晶片 | 国标委发〔2024〕28号20241911-T-469 | - | - | 7 | 2025.10.28 |
|  | 碳化硅单晶 | 国标委发〔2024〕28号20241932-T-469 | - | 3 | 8 | 2025.12.28 |
|  | 太阳能电池用砷化镓单晶及抛光片 | 国标委发〔2024〕28号20241934-T-469 | - | 5 | 8 | 2025.10.28 |
|  | 300 mm硅外延片 | [国标委发〔2024〕44号](http://zxd.sacinfo.org.cn/gb_notice/1727662175388.doc%22%20%5Ct%20%22https%3A//std.samr.gov.cn/noc/search/_blank)20243061-T-469 | - | 5 | 11 | 2026.3.29 |
|  | 金刚石单晶抛光片 | [国标委发〔2024〕44号](http://zxd.sacinfo.org.cn/gb_notice/1727662175388.doc%22%20%5Ct%20%22https%3A//std.samr.gov.cn/noc/search/_blank)20243062-T-469 | - | 8 | 11 | 2026.3.29 |
|  | 激光器外延芯片用砷化镓衬底 | [国标委发〔2024〕44号](http://zxd.sacinfo.org.cn/gb_notice/1727662175388.doc%22%20%5Ct%20%22https%3A//std.samr.gov.cn/noc/search/_blank)20243065-T-469 | - | 8 | 11 | 2026.3.29 |
|  | 三氯化镓 | 工信厅科[2024]18号2024-0075T-YS | - | - | 8 | 2026.3.15 |
|  | 高纯砷 | 工信厅科[2024]18号2024-0218T-YS | - | - | 5 | 2025.9.15 |
|  | 流化床法颗粒硅用籽晶 | 工信厅科函〔2024〕317号2024-0936T-YS | - | - | 3 | 2025.8.14 |
|  | 硅多晶用硅粉理化性能的测定 第 1 部分：有效硅含量的测定 重量法 | 工信厅科函〔2024〕352号[2024-1002T-YS](http://124.127.195.159:8080/TaskBook.aspx?id=20241002TYS) | - | 3 | 7 | 2025.9.14 |
|  | 硅多晶用硅粉理化性能的测定 第 2 部分：浊度的测定散射光法 | 工信厅科函〔2024〕352号[2024-1003T-YS](http://124.127.195.159:8080/TaskBook.aspx?id=20241003TYS) | - | 3 | 7 | 2025.9.14 |
|  | 流化床法颗粒硅表面金属含量的测定 酸浸取-电感耦合等离子体质谱法 | 工信厅科函〔2024〕352号[2024-1004T-YS](http://124.127.195.159:8080/TaskBook.aspx?id=20241004TYS) | - | 3 | 7 | 2025.9.14 |
|  | 多晶硅生产企业节能诊断技术规范 | 工信厅科函〔2024〕191号2024-0734T-YS | - | 3 | 7 | 2026.5.24 |
|  | 半导体外延用等静压石墨 | 中色协科字〔2024〕80号[2024-063-T](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=20240075TYS)/CNIA | - | 5 | 11 | 2025.12.31 |
|  | 硅多晶用包装袋内表面杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 中色协科字〔2024〕80号[2024-064-T](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=20240075TYS)/CNIA | - | 7 | 11 | 2025.12.31 |
|  | 300 mm硅片表面纳米形貌的评价方法 | 已公示 | 5 | - | - | - |
|  | 碳化硅粉 | 已公示 | 8 | - | - | - |
|  | 氮化铝单晶复合衬底 | 已公示 | 5 | - | - | - |
|  | 集成电路用高纯硅靶材 | 已公示 | 5 | - | - | - |